

光大证券股份有限公司关于无锡力芯微电子股份有限公司
2024年年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：光大证券股份有限公司	被保荐公司名称：无锡力芯微电子股份有限公司
保荐代表人姓名：王如意	联系方式：021-22169999 联系地址：上海市静安区新闻路 1508 号
保荐代表人姓名：林剑云	联系方式：021-22169999 联系地址：上海市静安区新闻路 1508 号

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“力芯微”“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责力芯微上市后的持续督导工作，并出具 2024 年年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作的情况

序号	工作内容	持续督导工作情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、现场检查等方式，对公司开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	本持续督导期间，公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	本持续督导期间，公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	本持续督导期间，公司及相关主体能切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以	保荐机构已督导公司进一步完善公司的治理制度并严格执行。

序号	工作内容	持续督导工作情况
	及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构督促公司进一步完善公司的内控制度并规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对公司的信息披露文件进行事前或事后的及时审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在上述情况。
12	关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，公司未出现该等事项。
14	在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	本持续督导期间，公司及相关主体未出现该等事项。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司	本持续督导期间，公司及相关主体未出现该等事项。

序号	工作内容	持续督导工作情况
	进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。	
16	持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	保荐机构对公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在 2024 年持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

在 2024 年持续督导期间，公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、产品迭代风险

随着下游应用领域的扩大及应用场景的变化，公司需要根据技术发展趋势和客户需求变化持续进行研发和创新，通过产品和技术的先进性来保持竞争力。报告期内，新产品的批量化销售通常会成为公司后续年度营业收入持续增长的重要推动力。如果公司无法持续进行技术创新和产品开发，将无法保持产品的正常迭代，将影响公司的市场竞争力，继而影响业绩的持续增长。

2、研发失败风险

研发创新是集成电路企业最重要的经营活动之一。为保持核心竞争力，公司需要充分结合行业技术前沿趋势和手机、可穿戴设备等下游领域的需求持续研发。随着业务规模和应用领域的扩大，公司将开展电源管理芯片及其他类芯片（如智能组网延时管理单元、信号链芯片等）在更多领域的应用和研发，研发投入可能持续加大。但由于产品研发需要投入大量资金和人力，耗时较长且存在一定的不确定性，如果出现公司产品研发未达预期或开发的新产品缺乏竞争力、推广不力等情形，公司将面临前期研发投入无法收回、持续竞争力被削弱的风险。

（二）经营风险

1、市场竞争风险

公司之产品广泛应用于消费电子领域，且正积极向工业控制、医疗器械及汽车电子等多元化领域拓宽。鉴于下游产品更新迅速，市场竞争异常激烈，公司采取精准的市场策略，主要聚焦于与下游知名客户建立并维护紧密的合作关系。在致力于新客户开发的同时，公司亦不断提升现有客户的满意度，确保产品出货量稳定，并积极推广新品。然而，公司在发展过程中亦面临国内外众多竞争对手的挑战，公司将保持高度警惕，持续优化战略布局，以适应不断变化的市场环境。

在国际市场中，公司在特定领域与 TI、ON Semi、DIODES、Richtek 等全球知名 IC 设计公司直接竞争，但在市场地位、整体技术实力、销售规模、产品种类齐全性等方面存在一定差距；在国内市场中，近年来消费电子市场的发展吸引了众多国内优秀的 IC 设计公司参与，也产生了一定的市场竞争。

如果公司未能准确把握市场和行业发展趋势，持续快速地进行技术和产品开发，未能充分利用客户资源将技术转换为产品并持续提升市场地位，竞争优势有可能被削弱，从而对公司的经营业绩产生不利影响。。

2、客户集中风险

本公司致力于模拟芯片的研发与销售，产品广泛应用于消费电子产品领域。2024 年度，公司前五大客户的销售份额达到了 66.04%。

尽管本公司与客户之间建立了稳固的合作关系，但若未来主要客户面临重大经营困境、采购需求显著减少或改变采购策略，可能会导致公司订单量急剧减少，进而对公司经营业绩产生负面影响。此外，若公司未能及时根据市场需求推出新产品，或连续多款新产品未能获得认证，这可能损害合作基础或造成客户流失，从而对公司经营业绩产生负面影响。

（三）财务风险

由于集成电路行业产品更新换代较快，通常具备性能优势和竞争优势的产品在推出市场时可获得较高的毛利率，随着时间推移和市场竞争，其毛利率空间逐渐被压缩，降低至一定程度后保持稳定。因此，芯片设计公司需要精准把握市场变化和客户个性化需求，通过持续的研发创新、新品推广来提升高毛利产品销售占比，以

保持稳定或较高的综合毛利率水平。若公司未能根据市场变化及时进行产品升级或开发，产品缺乏竞争力或在市场竞争中处于不利局面，可能出现产品售价下降，使得毛利率水平出现波动；此外，如果公司市场推广不力，高毛利率产品销售占比下降也会导致公司综合毛利率水平出现波动，进而对公司经营业绩产生不利影响。

公司存货主要为芯片及晶圆，为保障供应链安全，公司投入了较大的资源。报告期期末，公司存货账面余额约为 19,398.72 万元。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，报告期期末，公司存货跌价准备余额为 4,729.81 万元，存货跌价准备计提的比例为 24.38%。未来市场加速下行，或者由于技术迭代导致产品更新换代加快，可能导致存货跌价风险提高，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（四）行业风险

公司产品主要包括电源转换芯片、电源防护芯片、显示驱动电路等电源管理芯片，以及智能组网延时管理单元、高精度霍尔芯片、信号链芯片等其他类芯片。除智能组网延时管理单元外，公司产品主要应用于消费电子领域。由于该行业是资本及技术密集型行业，随着技术的更迭，行业本身呈现周期性波动的特点，并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。

（五）宏观环境风险

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售，属于集成电路行业上游环节。全球集成电路行业是资本及技术密集型行业，随着技术的更迭，行业本身呈现周期性波动的特点，并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。2024 年度，受到地缘政治形势以及通货膨胀等因素的叠加影响，消费电子领域市场规模受到了较强的冲击，导致行业发生较大波动，使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险，对经营情况造成一定的不利影响。

四、重大违规事项

无。

五、主要财务数据及指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要财务数据	2024年度	2023年度	增减幅度（%）
营业收入	787,493,272.86	886,754,179.96	-11.19
归属于上市公司股东的净利润	125,857,356.24	200,508,679.29	-37.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,968,381.01	177,542,750.03	-40.88
经营活动产生的现金流量净额	133,182,057.77	213,932,211.76	-37.75
主要财务数据	2024/12/31	2023/12/31	增减幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,265,205,242.07	1,260,334,511.46	0.39
总资产	1,457,482,636.73	1,466,856,407.79	-0.64
股本	133,692,700.00	133,692,700.00	0.00
主要财务指标	2024年度	2023年度	增减幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.94	1.50	-37.33
稀释每股收益（元/股）	0.94	1.50	-37.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.79	1.33	-40.60
加权平均净资产收益率（%）	9.87	17.01	减少7.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.23	15.06	减少6.83个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	17.85	12.13	增加5.72个百分点

（一）归属于上市公司股东的净利润同比下降 37.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 40.88%，主要系 2024 年度，受行业竞争态势加剧及下游市场各领域需求复苏节奏差异影响，营业收入同比有所下降。为持续强化中长期核心竞争力，丰富公司产品系列以覆盖更多的下游应用领域，公司本年度研发费用投入较上年有所增加，另鉴于公司所处消费电子行业具有技术迭代迅速、产品生命周期较短的行业特性，基于谨慎性原则，对存货进行减值测试并计提跌价准备，本报告期计提资产减值损失较上年同期增加较多，综上因素，本报告期的利润较上年有所下降。

（二）经营活动产生的现金流量净额同比下降 37.75%，主要原因：一是销售规模减少，相应销售商品收到的现金也减少，二是收到政府补助较上年有减少，三是加大公司团队建设，为职工支付的薪酬费用增加。

（三）基本每股收益同比下降 37.33%，稀释每股收益同比下降 37.33%，扣除

非经常性损益后的基本每股收益同比下降 40.60%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）出色的研发能力

设计及创新是集成电路设计公司保持核心竞争优势的重要手段。由于模拟电路设计的实现依赖于设计团队对电子产品物理特性、工艺的理解以及拓扑结构设计、布线布图的经验，因此，模拟电路设计需要设计团队具备丰富的设计经验和技術积累。

公司深耕电源管理芯片领域二十余年，结合市场需求和前沿信息持续创新，围绕电源管理芯片低噪声、高效能、微型化及集成化等发展趋势形成了丰富的核心技术和功能模块 IP，并以此为基础形成了覆盖电源转换、电源防护、信号链等多类别设计平台。公司上述技术体系是经过多年研发积累而形成的，在应用中得到市场验证并不断优化，为研发团队提供了大量先进成熟的基础架构的同时，保持了一定的先进性。研发团队在设计平台中调用各种成熟的模块 IP 并应用于电路设计中，可以更好地形成电源解决方案并快速实现研发目标，保障了研发的准确性和高效率。公司通过多年积累形成的市场针对性强、应用价值大的技术体系，使得公司具备出色的创新能力。

（二）产品性能及可靠性优势

性能及可靠性是衡量芯片水平的重要维度，亦是客户选择芯片设计企业和产品的重要因素。凭借优质的产品、快速反应的研发体系和差异化服务，公司在特定领域与 TI、ON Semi、DIODES、Richtek 等全球知名 IC 设计公司的部分产品竞争，且部分产品性能指标已经达到或超过国际品牌的竞标产品。与此同时，在产品可靠性方面，公司持续引进和采用先进的质量管理理念，在研发及生产过程中执行严格、完善的质量控制体系，将高标准的质量管控体系贯穿产品设计及生产环节。

公司引入先进的设计管理理念和流程，严格控制公司的产品质量和设计效率，在设计环节即需考虑产品的品质、性能参数的余量、产品的可测试性，并确定包括 ATE 测试方案、应用测试方案、可靠性考核方案在内的可测性方案，从测试覆盖率、极限应用环境模拟、加速寿命测试等多维度考核产品可靠程度；在流片及封装测试

环节，公司分别执行 PCM 参数监控及在线参数监控等关键质量环节的数据监控、分析，实现对生产过程的质量控制。

名称	目的	具体介绍
ATE 测试	提高测试覆盖率	设计时适当增加专门用于测试的电路，确保各个模块得到验证覆盖，从而加强电路的可控制性和可观察性，降低电路的测试难度和复杂性，提高电路的测试效率。
应用测试	极限应用环境模拟	设计不同应用环境和测试方法，模拟极限应用环境下产品指标的可实现性，极限条件下的应用测试有助于尽快和全面地考察产品的各项特性。
可靠性验证	确保产品可靠性	公司设立了可靠性实验室，建立了严格且完善的可靠性验证体系并严格执行可靠性试验管理程序，能够自主完成回流焊、高加速应力、高低温冲击、高温存储、高低温寿命测试、稳态湿热、高温水蒸气压力、静电模拟放电等测试验证项目，并制定了针对新品、量产等不同阶段的考核要求。

此外，为应对风险和异常情况，公司制定了健全的风险评估方案及接收标准，当触发质量异常事件的条件后，公司将启动至少包括设计、工程、质量的会议评审，及时深度挖掘导致异常的原因，并确保产品在触发异常管控之后没有风险产品流出至客户。

通过对产品不同阶段完善的测试、考核，公司确保产品在不同应用环境下保持稳定的性能，使得公司产品在客户产线生产的上线失效率（DPPM）（即每百万颗产品失效个数）远低于客户要求，树立了高可靠性的品牌形象。

（三）客户资源优势

集成电路对终端电子产品性能、安全性发挥着重要作用，客户不仅要求芯片能满足性能指标，还需要具备高可靠性。因此，为降低产品风险，客户对供应商资质认证的门槛高、时间长，并需对产品进行验证和反复测试，但进入供应商体系后合作相对稳定，具有较高的客户认证壁垒。

消费电子领域，特别是手机领域的市场格局高度集中。公司自 2010 年正式进入三星电子的供应商体系，在国际业务中与 TI 等国际知名企业竞标，积累了大量的开发经验。公司以国际客户的质量要求为准绳，形成了出色的研发能力和严格的质量控制体系，逐步形成了良好的市场口碑，并通过小米、LG、闻泰等主流消费电子品牌供应商认证。

目前，公司终端客户已覆盖三星、小米、美的、海尔、LG 等国内外知名消费电子品牌。凭借出众的产品性能和稳定的产品质量，公司与上述客户保持了良好合作

关系，合作领域从手机、可穿戴设备逐步拓展至家电、汽车电子等业务板块，合作进一步加深，形成了良好的客户优势。汽车电子领域，目前公司多种产品已经服务于比亚迪、现代汽车等知名客户。

（四）产业链协同优势

为确保设计的可实现性，集成电路设计企业需要及时掌握下游市场需求及技术变化，并充分了解供应商的工艺变化、产能情况。公司与全球排名领先、工艺先进且成熟度高的主流晶圆制造、封装测试企业保持了长期稳定的合作关系，充分了解其工艺水平及变化情况，使得公司能够提前介入、磨合上游技术资源，进而将上下游技术、工艺资源、应用需求融入产品研发之中，实现产业链需求-工艺-设计的动态传导和有效的产业链资源协同。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2024 年度，研发费用本年度较上年度增长 30.63%，主要系扩充研发人员，研发人员薪酬增加较多所致。

（二）研发进展

2024 年度，公司新增知识产权项目申请 42 项（其中发明专利 24 项），共获得了 52 项知识产权项目（其中发明专利 40 项）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得知识产权项目授权 191 项，其中发明专利授权 96 项、实用新型专利 31 项、外观设计专利 1 项、软件著作权 9 项、集成电路布图设计专有权 54 项，具体情况如下：

知识产权类别	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	24	40	127	96
实用新型专利	4	5	35	31
外观设计专利	-	-	1	1
软件著作权	3	3	9	9
其他	11	4	62	54
合计	42	52	234	191

公司在研项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	17,889.96	750.17	13,446.29	已研发完成产品并逐步量产、销售	电源转换和驱动芯片，是在公司现有产品线上的继续深入研究和开发，基于目前已经取得的各项技术，不断深入分析和研究系列产品的开发，电源转换和驱动芯片，包括各类电源转换电路如 LDO 产品、DCDC 产品、充电管理芯片、以及 LED 驱动芯片等。	行业领先	面向智能手机以及手机周边的手表、手环、TWS 耳机等便携设备，也将推广至家电、工业、医疗方面。
2	高性能电源防护芯片研发及产业化项目	17,036.17	4,430.36	11,130.44	已研发完成部分产品并逐步试产、送样	电源防护芯片，包括公司的压防护产品、电流防护产品及电源开关产品，在公司现有产品线上的继续深入研究和开发，基于目前已经取得的各项技术，不断深入分析和研究系列产品的开发及量产。	行业领先	面向智能手机以及手机周边的手表、手环、TWS 耳机等便携设备，笔记本和 PAD 市场，车载电子市场。
3	信号链芯片深入研发及产业化	10,000.00	2,326.58	4,709.34	已研发完成部分产品并逐步试产、送样	主要面向高频或微弱信号等，对分辨率、灵敏度、可靠性、噪声等指标的要求较高。	行业领先	除消费电子外，也将面向工业、汽车、医疗领域。
4	磁感应芯片系列研发及产业化	3,000.00	795.64	2,057.21	已研发完成部分产品并逐步试产、送样	1、除检测磁场外，可识别磁场方向、数值等，功能更加丰富； 2、对敏感度和噪声等性能指标要求更高。	行业领先	工业自动化、定位系统、信息处理、便携设备、汽车电子等，应用领域更加广泛。
5	电源管理单元（PMU）研发及产业化	5,000.00	1,198.68	4,845.47	已研发完成系列产品并逐步试产、送样	充分发挥公司在电源管理领域良好布局优势，拉开与竞争对手差距。	行业领先	面向智能手机以及手机周边的手表、手环、TWS 耳机等便

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
								携设备。
6	超低功耗线性电源转换芯片	1,925.00	1,672.52	1,672.52	持续研发阶段	1.完善稳定的拓扑结构架构； 2.在完成拓扑结构的情况下，针对汽车应用领域，开发出带可编程限流，输入输出防倒灌种等功能性IP设计； 3.更新产品线，将现有40V BCD工艺升级到60V BCD以上工艺，驱动电流要求提升至1A； 4.完成汽车供电应用场合下的各种可靠性测试。	行业领先	为所有特殊车载电子系统提供电源输入的主电源必须能够承受各种瞬态电压状态。
7	高频低纹波 DCDC 控制芯片	2,000.00	705.16	705.16	持续研发阶段	采用频率同步功能，将变换器内部开关频率锁定为与外部时钟相同的频率，降低了滤波电路设计的成本。轻载下采用脉冲跨周期调制 (PSM) 模式从而提高转换效率，也可选择强迫脉冲宽度调制 (FPWM) 模式从而降低输出纹波电压。在 PSM 模式下，每个开关周期之后都有一段休眠时间，从而实现低待机功耗。	行业领先	应用于汽车、车联网系统、工业电力系统和数字机顶盒等应用场景。
8	高可用工业电子雷管起爆系统项目	1,300.00	626.62	1,131.47	持续研发阶段	针对电子雷管从芯片、模组到电子雷管的一整套自动化生产管理，通过强化执行过程的质量管控，将生产大数据管理贯穿于生产经营的每个环节，全面做到精细化管理和理论依托数据，从而保证产品质量，降低成本，减少人为干扰，进一步提升现有通用型电子雷管控制模块的发火性能和可靠性。同时，	行业领先	工业电子雷管的全自动生产和数据自动汇总和追溯。民用爆破，地震波勘探，油气井射孔等应用。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						通过使用配套的起爆控制系统，对电子雷管模组进行在线编辑，检测，支持不同的起爆方案。并能排查、修复和解决起爆过程中遇到的异常问题，提高雷管起爆率，提升现场作业效率。		
9	高性能工业电子雷管模组开发项目	1,500.00	579.98	1,227.97	持续研发阶段	项目在两年的时间内完成高性能工业电子雷管控制芯片及模组的开发工作，产品性能达到国际领先水平；性价比超过国外同类产品。	行业领先	民用爆破，地震波勘探，油气井射孔等应用。
10	数码电子雷管全生命周期管理与数据分析系统	400.00	79.89	399.36	研发完成	通过数码电子雷管全生命周期管理系统，雷管厂可在总体上把控产品的生产、销售、存储和使用等情况，为企业的经营决策提供支持依据。通过数据分析系统，雷管厂实现对爆破公司的施工、爆破、销售和使用情况的总体了解，为产品的销售和服务提供支撑。	行业领先	工业电子雷管的行业化应用。民用爆破，地震波勘探，油气井射孔等应用。
11	深部资源勘探无线双模电子雷管模组和系统的研发	1,340.00	86.09	86.09	持续研发阶段	通过本项目实施，突破我国面向深部资源勘探开发的无线双模组网电子雷管模组核心芯片设计、管控系统开发、制造技术难题；发展我国面向深部资源开发的未来产业新质生产力，在国内首创支持无线组网的电子雷管模组和系统。	行业领先	深部能源勘探开采、金属矿石开采等工业爆破领域。
12	车用 2A/36V 高效率同步降压转换集成电路	390.00	221.20	396.50	研发完成	项目在三年内完成符合 AEC-Q100 的车用 2A/36V 高效率同步降压转换集成电路的研发和产业化工作，产品性能达到国际水平，进入国内外车	行业领先	2A/36V DC/DC 直流转换器广泛应用于汽车内各个模块，是车

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						企。		内、特别是新能源车内最常使用的电源转换器电路。
13	高可靠车载电源驱动控制电路的研发	500.00	221.08	362.42	持续研发阶段	本项目拟攻克降压控制芯片超低功耗、高频率、高效率、快速响应、稳定可靠性能要求，形成适于车载电源应用的系列产品。	行业领先	汽车 ADAS、车载电子仪表系统、车身照明系统等。
14	低噪声高可靠电源开关芯片的研发	350.00	361.96	361.96	研发完成	本项目拟解决开关损耗（温度表征）和开关噪声（尖峰电压）技术痛点，形成高效率电源开关芯片系列产品。	行业领先	智慧医疗、移动终端、智能家居等。
合计	/	62,631.13	14,055.93	42,532.20	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,600.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 36.48 元，本次发行募集资金总额为人民币 583,680,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 71,236,470.12 元，募集资金净额为人民币 512,443,529.88 元。

上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具容诚验字[2021] 230Z0102 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	583,680,000.00
减：发行相关费用	71,236,470.12
募集资金净额	512,443,529.88
减：置换预先投入募投项目资金	48,604,191.63
直接投入募投项目资金	382,205,563.67
其中：本期投入募投项目资金	96,904,856.39
永久补充流动资金	4,121,173.66
加：利息收入扣除手续费净额	23,825,224.56
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	101,337,825.48
其中：存放募集资金专户余额	101,337,825.48
募集资金现金管理余额	0

注：截至2024年12月31日，公司永久补充流动资金4,121,173.66元，为募投项目结项时的节余募集资金（含利息）。

（二）募集资金使用情况

1、节余募集资金使用情况

结合公司实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，经公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”节余资金 4,121,173.66 元已转入公司一般户，对应募集资金专户已销户。

2、募投项目延期的具体情况

受国际经济、行业环境等宏观因素的不确定性影响，公司部分募投项目对应产品市场情况发生变化，公司需要更多时间来掌握最新市场需求，并根据市场的实际需求情况来调整募投项目的执行时间。同时，随着行业技术的革新，公司从长远发展的角度出发，对部分募投项目的相关技术和方案作进一步优化调整，以提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面，提高公司自主创新能力。综上，公司经审慎研究，将“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”“发展储备项目”达到预定可使用状态日期相应延期。

综合考虑公司未来发展、后续项目建设、使用效果等情况，公司将重新购置新的研发场地，作为募投项目“研发中心建设项目”的实施地点，目前仍在寻找过程中。根据上述募投项目投资和建设进度，经审慎研究，公司将上述募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期。公司将积极寻找合适的募投项目实施用地，推动募投项目的顺利实施。

经公司于2024年4月29日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	高性能电源防护芯片研发及产业化项目	2024年6月	2025年6月
2	研发中心建设项目	2024年6月	2026年6月
3	发展储备项目	2024年6月	2025年6月

3、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年8月27日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过2亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币0元。

（三）募集资金使用是否合规

公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、

冻结及减持情况

公司原实际控制人袁敏民、毛成烈、周宝明、佘东辉、张亮、汤大勇、汪东、汪芳已确认《一致行动协议》于 2024 年 6 月 27 日到期后不再续签，各方一致行动关系于 2024 年 6 月 27 日到期后终止。一致行动关系到期解除后，公司由原八名一致行动人共同控制变更为无实际控制人。

2024 年度，公司控股股东、（原）实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

姓名	职务	期初持股数（股）		期末持股数（股）	
		直接持股数量	间接持股数量	直接持股数量	间接持股数量
无锡亿晶投资有限公司	控股股东	57,844,780	-	53,833,999	-
袁敏民	原实际控制人、董事长、总经理	-	14,807,292	-	13,780,599
毛成烈	原实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书	-	5,692,909	-	5,298,180
周宝明	原实际控制人、董事	-	5,692,909	-	5,298,180
佘东辉	原实际控制人	-	5,275,709	-	4,909,907
张亮	原实际控制人、副总经理	-	4,952,377	-	4,608,994
汤大勇	原实际控制人	-	4,649,904	-	4,327,494
汪东	原实际控制人、董事、副总经理	-	4,128,413	-	3,842,161
汪芳	原实际控制人	-	3,565,193	-	3,317,993
赵志东	董事	-	-	-	-
毕英	董事	-	-	-	-
陈嘉琪	独立董事	-	-	-	-
睦鸿明	独立董事	-	-	-	-
陶建中	独立董事	-	-	-	-
夏勇杰	监事会主席	-	273,728	-	254,749
伍旻	监事	-	211,148	-	196,508

王磊	职工监事	-	-	-	-
董红	财务总监	-	248,867	-	231,611

2024 年 7 月 17 日，无锡亿晶投资有限公司通过询价转让方式减持公司股份 4,010,781 股，占公司总股本的 3.00%。本次询价转让后，无锡亿晶投资有限公司持有公司股份比例从 43.27%减少至 40.27%。公司董事、监事和高级管理人员通过无锡亿晶投资有限公司间接持有上市公司股份数量对应减少。

2024 年度，公司控股股东、（原）实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

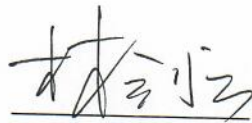
（以下无正文）

(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告》的签章页)

保荐代表人：



王如意



林剑云

